



DIN Normen Leiterplatten – Kurzfassung

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (kurz DIN) ist die nationale Normungsorganisation der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin.

DIN Normen - Kurzfassung (Quelle [IHS](#) und [Institut für Normung e. V.](#))

DIN 19220

Verfahren zur Deklaration von Materialien in Produkten der Elektro- und Elektronikindustrie

DIN 41612 / IEC-60603-2

Diese ergänzenden Bauteile der DIN 41612 / IEC 60603-2 Steckverbinderfamilie sind für alle gängigen Bauformen wie B, C, D, F H, Q, R und kurze Bauformen erhältlich. Die Kabelgehäuse bieten wahlweise 3 Kabelabgänge mit einer Zugentlastung für Litzen, Rundkabel oder Flachbandkabel. Die Führungselemente sind mit Kodierung und Schraubverriegelung für 19" Anwendungen verfügbar.

DIN 41612

IEC 130-14 VG95324 für die 19"-Bauweise von elektronischen Einrichtungen nach DIN 41494 - Steckverbinderfamilie für Leiterplatten

DIN 41622-1

Steckkontaktleisten mit Messerkontakten 3 × 1 mm; Masse

DIN 43460

Kontaktbelegung von Steckverbindern - Leistungsschalter mit Bemessungsspannungen < 52 kV - Zuordnung von Hilfs- und Steuerstromkreisen

DIN EN 50279

Optische Anzeigeeinheiten - Messverfahren für niederfrequente elektrische und magnetische Nahfelder; Deutsche Fassung 50279:1997

DIN EN 61189-3:2008-06

Prüfverfahren für Elektromaterialien, Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen und Baugruppen - Teil 3: Prüfverfahren für Verbindungsstrukturen (Leiterplatten) (IEC 61189-3:2007); Deutsche Fassung EN 61189-3:2008

DIN EN 60191-6-13

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen - Teil 6-13: Konstruktionsleitfaden für Open Top Fassungen für Feinraaster-Ball-Grid Array und Feinraaster Land Grid Array (FBGA/FLGA) (IEC47D/620/CDV:2005); Deutsche Fassung 60191-6-13:2005

DIN EN 60191-6-16

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen - Teil 6-16: Glossar für Fassungen für die Prüfung und Voralterung von BGA, LGA, FBGA und FLGA (IEC 47D/621/CDV:2005); Deutsche Fassung 191-6-16:2005

DIN EN 60617-5

Graphische Symbole für Schaltpläne - Teil 5: Schaltzeichen für Halbleiter und Elektronenröhren (IEC 60617-5:1996); Deutsche Fassung EN 60617-5:1996

DIN EN 60749-26

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren - Teil 26: Prüfung der Empfindlichkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD) - Human Body Model (HBM) (IEC 47/1803/CDV:2005); Deutsche Fassung 60749-26:2005

DIN EN 60749-27

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prüfverfahren - Teil 27: Prüfung der Empfindlichkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD) – Machine Model (MM) (IEC 47/1804/CDV:2005); Deutsche Fassung 60749-27:2005

DIN EN 61076-3-112

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-112: Rechteckige Steckverbinder - Bauartspezifikation: Rechteckige Steckverbinder mit vier Kontakten für serielle Hochgeschwindigkeitsbusse in Audio- und Videosystemen (IEC 48B/1478/CDV:2004); Deutsche Fassung 61076-3-112:2004

DIN EN 61188-5-3

Leiterplatten und Flachbaugruppen - Konstruktion und Anwendung - Teil 5-3: Sektionale Anforderungen - Betrachtungen zur Montage (Anschlussfläche/Verbindung) - Bauelemente mit Gullwing-Anschlüssen auf zwei Seiten (IEC 91/463/CDV:2004); Deutsche Fassung 61188-5-3:2004

DIN EN 61188-5-4

Leiterplatten und Flachbaugruppen - Konstruktion und Anwendung - Teil 5-4: Sektionale Anforderungen - Betrachtungen zur Montage (Anschlussfläche/Verbindung) - Bauelemente mit J-förmigen Anschlüssen auf zwei Seiten (IEC 91/464/CDV:2004); Deutsche Fassung 61188-5-4:2004

DIN EN 61188-5-5

Leiterplatten und Flachbaugruppen - Konstruktion und Anwendung - Teil 5-5: Sektionale Anforderungen - Betrachtungen zur Montage (Anschlussfläche/Verbindung) - Bauelemente mit Gullwing-Anschlüssen auf vier Seiten (IEC 91/465/CDV:2004); Deutsche Fassung 61188-5-5:2004

DIN IEC 61249-3-1

Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen - Teil 3-1: Kupferkaschierte Lamine für flexible Leiterplatten (Ausführungen mit und ohne Kleber-Zwischenschicht) (IEC 91/752/CD:2008)

DIN EN 61249-3-3:1999-11

Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen - Teil 3-3: Rahmenspezifikationen für unverstärkte kaschierte und unkaschierte Basismaterialien (für flexible Leiterplatten); Kleberbeschichtete flexible Polyesterfolien (IEC 61249-3-3:1999); Deutsche Fassung EN 61249-3-3:1999

DIN EN 61249-4-1

Materialien für Verbindungsstrukturen - Teil 4-1: Rahmenspezifikationen für unkaschierte Prepreg-Materialien (zur Herstellung von Mehrlagenleiterplatten) - Mit E-Glasgewebe verstärkte Epoxidharz-Prepregs mit definierter Brennbarkeit (Brennprüfung mit vertikaler Prüflingslage) (IEC 91/573/CDV:2005); Deutsche Fassung 61249-4-1:2005

DIN EN 61360-2

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile - Teil 2: Express-Datenmodell (IEC 61360-2:2002 + A1:2003); Deutsche Fassung EN 61360-2:2002 + A1:2004, Text Englisch

DIN EN 61360-4

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile - Teil 4: IEC Nachschlagewerk für genormte Datenelementtypen, Bauteilklassen und Terme (IEC 61360-4:2005); Deutsche Fassung EN 61360-4:2005, Text Englisch

DIN EN 61360-5

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile - Teil 5: Erweiterung des Express-Datenmodells (IEC 61360-5:2004); Deutsche Fassung EN 61360-5:2004, Text Englisch

DIN EN 61523-1

Berechnung von Verzögerung und Leistungsaufnahme beim Entwurf von Chips - Teil 1: System zur Berechnung von Verzögerung und Leistungsaufnahme integrierter Schaltkreise (IC) (IEC 61523-1:2001); Deutsche Fassung EN 61523-1:2002, Text in Englisch

DIN EN 61523-2

Berechnung von Verzögerung und Leistungsaufnahme beim Entwurf von Chips - Teil 2: Vorgezogene Berechnung der Verzögerung für CMOS-ASIC-Bibliotheken (IEC 61523-2:2002); Deutsche Fassung EN 61523-2:2002, Text in Englisch

DIN EN 61747-3

Flüssigkristall-Anzeige-Bauelemente - Teil 3: Rahmenspezifikation für Flüssigkristall-Anzeigezellen (LCD-Zellen) (IEC 110/48/CDV:2005); Deutsche Fassung 61747-3:2005

DIN EN 61747-3-1

Flüssigkristall-Anzeige-Bauelemente - Teil 3-1: Flüssigkristall-Anzeigezellen (LCD-Zellen) - Vordruck für Bauartspezifikation (IEC 110/49/CDV:2005); Deutsche Fassung 61747-3-1:2005

DIN EN 62014-1

Bibliotheken für die Entwurfsautomatisierung - Teil 1: Spezifikation von Eigenschaften von I/O-Buffern (IBIS Version 3.2) (IEC 62014-1:2001); Deutsche Fassung EN 62014-1:2002

DIN EN 62258-2

Halbleiter-Chip-Erzeugnisse - Teil 2: Datenaustausch-Formate (IEC 62258-2:2005); Deutsche Fassung EN 62258-2:2005, Text Englisch

DIN EN 62326-4:1997-08

Leiterplatten - Teil 4: Starre Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen; Rahmenspezifikation (IEC 62326-4:1996); Deutsche Fassung EN 62326-4:1997

DIN EN 140100

Rahmenspezifikation: Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit; Deutsche Fassung 140100:2006

DIN EN 140101

Vordruck für die Bauartspezifikation: Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit; Deutsche Fassung 140101:2006

DIN EN 140101-806

Bauartspezifikation: Schicht Festwiderstände niedriger Belastbarkeit - Metallschichtwiderstände auf hochwertiger Keramik, mit konformer Umhüllung und axialen oder vorgeformten Anschlüssen; Deutsche Fassung 140101-806:2006

DIN EN 140401-801

Bauartspezifikation: SMD Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit - Rechteckig - Stabilitätsklassen 0,1; 0,25; 0,5; 1; Deutsche Fassung 140401-801:2006

DIN EN 140401-802

Bauartspezifikation: SMD Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit - Rechteckig - Stabilitätsklassen 1; 2; Deutsche Fassung 140401-802:2006

DIN EN 140401-803

Bauartspezifikation: SMD Schicht-Festwiderstände niedriger Belastbarkeit - Zylindrisch - Stabilitätsklassen 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; Deutsche Fassung 140401-803:2006

DIN EN 175301-801

Bauartspezifikation: Hochpolige Rechteck-Steckverbinder mit runden auswechselbaren Crimpkontakten; Deutsche Fassung 175301-801:2005 DIN EN 175301-803

DIN EN 190000

Fachgrundspezifikation: Monolithische integrierte Schaltungen; Deutsche Fassung EN 190000:1995

DIN EN ISO 11145

Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen - Begriffe und Formelzeichen (ISO 11145:2006)

DIN EN ISO 11146-1

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für Laserstrahlmessungen, Divergenzwinkel und Beugungsmasszahlen - Teil 1: Stigmatische und einfach astigmatische Strahlen (ISO 11146-1:2005)

DIN EN ISO 11146-2

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für Laserstrahlmessungen, Divergenzwinkel und Beugungsmasszahlen - Teil 2: Allgemein astigmatische Strahlen (ISO 11146-2:2005)

DIN EN ISO 11151-1

Laser und Laseranlagen - Optische Standardkomponenten - Teil 1: Komponenten für den UV, sichtbaren und nah-infraroten Spektralbereich (ISO 11151-1:2000)

DIN EN ISO 11151-2

Laser und Laseranlagen - Optische Standardkomponenten - Teil 2: Komponenten für den infraroten Spektralbereich (ISO 11151-2:2000)

DIN EN ISO 11252

Laser und Laseranlagen - Lasergerät - Mindestanforderungen an die Dokumentation (ISO 11252:2004)

DIN EN ISO 11254-1

Laser und Laseranlagen - Bestimmung der laserinduzierten Zerstörschwelle optischer Oberflächen - Teil 1: 1-auf-1-Prüfung (ISO 11254-1:2000)

DIN EN ISO 11254-2

Laser und Laseranlagen - Bestimmung der laserinduzierten Zerstörschwelle optischer Oberflächen - Teil 2: S-auf-1-Prüfung (ISO 11254-2:2001); Deutsche Fassung EN ISO 11254-2:2001

DIN EN ISO 11551

Optik und optische Instrumente - Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für den Absorptionsgrad von optischen Laserkomponenten (ISO 11551:2003)

DIN EN ISO 11553-1

Sicherheit von Maschinen - Laserbearbeitungsmaschinen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen (ISO 11553-1:2005)

DIN EN ISO 11554

Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für Leistung, Energie und Kenngrößen des Zeitverhaltens von Laserstrahlen (ISO 11554:2006)

DIN EN ISO 11670

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für Laserstrahlparameter - Strahllagestabilität (ISO 11670:2003)

DIN EN ISO 11670

Berichtigungen zu DIN EN ISO 11670:2003-10

DIN EN ISO 11807-1

Integrierte Optik - Begriffe - Teil 1: Grundbegriffe und Formelzeichen (ISO 11807-1:2001)

DIN EN ISO 11807-2

Integrierte Optik - Begriffe - Teil 2: Begriffe für die Klassifizierung (ISO 11807-2:2001)

DIN EN ISO 11810-1

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren und Einstufung zur Laserresistenz von Operationstüchern und/oder anderen Abdeckungen zum Schutz des Patienten - Teil 1: Primäre Entzündung und Laserdurchstrahlung (ISO 11810-1:2005)

DIN EN ISO 11990

Optik und optische Instrumente - Laser und Laseranlagen - Bestimmung der Laserresistenz des Schaftes von Trachealtuben (ISO 11990:2003)

DIN EN ISO 12005

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für Laserstrahlparameter - Polarisation (ISO 12005:2003)

DIN EN ISO 13694

Optik und optische Instrumente - Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für die Leistungs-(Energie-)dichteverteilung von Laserstrahlen (ISO 13694:2000)

DIN EN ISO 13695

Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für die spektralen Kenngrößen von Lasern (ISO 13695:2004)

DIN EN ISO 13697

Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für die spekulare Reflexion und die gerichtete Transmission von optischen Laserkomponenten (ISO 13697:2006)

DIN EN ISO 14880-1

Mikrolinsenarrays - Teil 1: Begriffe (ISO 14880-1:2001 + Corr. 1:2003)

DIN EN ISO 14880-3

Optik und Photonik - Mikrolinsenarrays - Teil 3: Prüfverfahren für optische Eigenschaften außer Wellenfrontaberrationen (ISO 14880-3:2006)

DIN EN ISO 14880-4

Optik und Photonik - Mikrolinsenarrays - Teil 4: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften (ISO 14880-4:2006)

DIN EN ISO 14881

Integrierte Optik - Schnittstellen - Kopplungsrelevante Parameter (ISO 14881:2001)

DIN EN ISO 15367-1

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für die Bestimmung der Wellenfrontform von Laserstrahlen - Teil 1: Begriffe und grundlegende Aspekte (ISO 15367-1:2003)

DIN EN ISO 15367-2

Laser und Laseranlagen - Prüfverfahren für die Bestimmung der Wellenfrontform von Laserstrahlen - Teil 2: Shack-Hartmann-Sensoren (ISO 15367-2:2005)

DIN EN ISO 15902

Optik und Photonik - Diffraktive Optik - Begriffe (ISO 15902:2004)

DIN EN ISO 17526

Optik und optische Instrumente – Laser und Laseranlagen – Lebensdauer von Lasern (ISO 17526:2003)

DIN EN ISO 22827-1

Abnahmeprüfungen für Nd:YAG-Laserstrahlschweißmaschinen – Maschinen mit Versorgung durch Lichtleitfaser – Teil 1: Lasereinrichtung (ISO 22827-1:2005)

DIN EN ISO 22827-2

Abnahmeprüfungen für Nd:YAG-Laserstrahlschweißmaschinen – Maschinen mit Versorgung durch Lichtleitfaser – Teil 2: Mechanische Bewegungseinrichtung (ISO 22827-2:2005)

DIN IEC 40/1119/CD

Änderung 2 zu IEC 60384-10: Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 10: Rahmenspezifikation; Oberflächenmontierbare Vielschichtkeramik in Festkondensatoren (IEC 40/1119/CD:1999)

DIN IEC 47A/596/CD

IEC 62113: Integrierte Schaltungen – Abkündigungsverfahren für Lieferanten und Verteiler (IEC 47A/596/CD:2000)

DIN IEC 91/197/CD

Prüfung 5E02: Oberflächenisolationswiderstand, Baugruppen (IEC 91/197/CD:2000)

DIN IEC 60050-581

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Teil 581: Elektromechanische Bauteile für elektronische Einrichtungen (IEC 1/1982/CDV:2006)

DIN IEC 60115-8

Festwiderstände zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 8: Rahmenspezifikation: Oberflächenmontierbare (SMD) Festwiderstände (IEC 40/1457/CD:2004)

DIN IEC 60115-8-1

Festwiderstände zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 8-1: Vordruck für Bauartspezifikation: Oberflächenmontierbare (SMD) Festwiderstände – Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1458/CD:2004)

DIN IEC 60191-1

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen – Teil 1: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von Einzelhalbleiterbauelementen (IEC 47D/607A/CD:2005)

DIN IEC 60194

Konstruktion, Herstellung und Bestückung von Leiterplatten – Begriffe und Definitionen (IEC 91/448/CDV:2004)

DIN IEC 60235-1

Messung der elektrischen Eigenschaften von Mikrowellenröhren; Teil 1: Begriffe

DIN IEC 60286-2

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung – Teil 2: Gurtung von Bauelementen mit einseitig herausgeführten Anschlüssen (IEC 40/1744/CD:2006)

DIN IEC 60286-3

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für die automatische Verarbeitung – Teil 3: Gurtung von oberflächenmontierbaren Bauelementen auf Endlogurten (IEC 40/1433/CD:2004)

DIN IEC 60286-3-VI

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung – Teil 3: Typ VI: Gurtung von oberflächenmontierbaren Bauelementen auf Blistergurten mit 4 mm Breite (IEC 40/1782/CD:2006)

DIN IEC 60297-3-104

Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Masse der 482,6-mm-(19-in-) Bauweise – Teil 3-104: Steckverbinderabhängige Schnittstellenmasse für Baugruppenträger und Baugruppen (IEC8D/304/CD:2004)

DIN IEC 60352-5

Lötfreie Verbindungen – Teil 5: Einpressverbindungen – Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 48B/1602/CD:2005)

DIN IEC 60384-3

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 3: Rahmenspezifikation: Oberflächenmontierbare Tantal-Festkondensatoren (IEC 40/1449/CD:2004)

DIN IEC 60384-3-1

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 3-1: Vordruck für die Bauartspezifikation - Oberflächenmontierbare Tantal-Festkondensatoren - Qualitätsbewertungsstufe E (IEC 40/1450/CD:2004)

DIN IEC 60384-4

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 4: Rahmenspezifikation - Aluminium Elektrolyt Kondensatoren mit festem (MnO₂) oder flüssigem Elektrolyten (IEC 40/1610/CD:2005)

DIN IEC 60384-4-1

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 4-1: Vordruck für Bauartspezifikation: Aluminium Elektrolyt Kondensatoren mit flüssigem Elektrolyten - Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1611/CD:2005)

DIN IEC 60384-4-2

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 4-2: Vordruck für Bauartspezifikation: Aluminium Elektrolyt Kondensatoren mit festem (MnO₂) Elektrolyten - Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1612/CD:2005)

DIN IEC 60384-18

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 18: Rahmenspezifikation - Oberflächenmontierbare Aluminium Elektrolyt Kondensatoren mit festem (MnO₂) oder flüssigem Elektrolyten (IEC 40/1613/CD:2005)

DIN IEC 60384-18-1

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 18-1: Vordruck für Bauartspezifikation: Oberflächenmontierbare Aluminium Elektrolyt Kondensatoren mit festen (MnO₂) Elektrolyten - Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1614/CD:2005)

DIN IEC 60384-18-2

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 18-2: Vordruck für Bauartspezifikation: Oberflächenmontierbare Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit flüssigem Elektrolyten - Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1615/CD:2005)

DIN IEC 60384-24

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 24: Rahmenspezifikation - Oberflächenmontierbare Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren mit leitfähigem Polymerfestkörper-Elektrolyten (IEC 40/1428/CD:2004)

DIN IEC 60384-24-1

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 24-1: Vordruck für Bauartspezifikation - Oberflächenmontierbare Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren mit leitfähigem Polymerfestkörper-Elektrolyten - Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1429/CD:2004)

DIN IEC 60384-25

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 25: Rahmenspezifikation - Oberflächenmontierbare Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit leitfähigem Polymerfestkörper-Elektrolyten (IEC 40/1430/CD:2004)

DIN IEC 60512-16-1

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-1: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16a: Federung und Überdehnungsschutz (IEC 48B/1561/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-3

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-3: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16c: Biegefestigkeit von Kontakten (IEC 48B/1563/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-5

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-5: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16e: Einzelziehkraft mit Lehre (IEC 48B/1565/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-6

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-6: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16f: Mechanische Widerstandsfähigkeit von Anschlüssen (IEC 48B/1566/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-7

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-7: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16g: Kontaktverformung nach dem Crimpen (IEC 48B/1567/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-8

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-8: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16h: Isolationshalterung bei Crimpverbindungen (IEC 48B/1568/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-9

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-9: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16i: Haltekraft der Erdungsfeder (IEC 48B/1569/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-11

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-11: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16k: Abzugskraft, Wickelverbindungen (IEC 48B/1570/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-13

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-13: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16m: Abwickeln, Wickelverbindungen (IEC 48B/1571/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-14

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-14: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16n: Biegefestigkeit von Flachsteckern (IEC 48B/1572/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-16

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16p: Verdrehfestigkeit von Flachsteckern (IEC 48B/1573/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-17

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-17: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16q: Zug- und Druckfestigkeit von Flachsteckern (IEC 48B/1574/CD:2005)

DIN IEC 60512-16-18

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-18: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16r: Simulierte Auslenkung von Kontaktstiften in Kontaktkammern (IEC 48B/1575/CD:2005)

DIN IEC 60512-25-1

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-1: Prüfung 25a - Übersprechen (IEC 48B/1431/CD:2004)

DIN IEC 60512-25-9

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-9: Signalintegritätsprüfung - Prüfung 25i: Externes Nebensprechen (Alien Crosstalk) (IEC 48B/1536/CD:2005)

DIN IEC 60512-26-100

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 26-100: Prüfaufbau, Aufbau für Messungen und Referenzbildung und Prüfungen der Funktionsfähigkeit und der Rückwärtskompatibilität für Steckverbinder nach IEC 60603 7 (Prüfungen 26a bis 26g) (IEC 48B/1690/CD:2006)

DIN IEC 60539-1

Direkt geheizte temperaturabhängige Widerstände mit negativem Temperaturkoeffizienten - Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 40/1769/CD:2006)

DIN IEC 60603-7-2

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-2: Bauartspezifikation für ungeschirmte freie und feste Steckverbinder, 8-polig, für Datenübertragungen bis 100 MHz (IEC 48B/1293/CD:2003)

DIN IEC 60603-7-5

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-5: Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, für Datenübertragung bis 250 MHz (Kategorie 6, geschirmt) (IEC 48B/1223/CD:2002)

DIN IEC 60603-7-7

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-7: Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8-polig, für Datenübertragungen bis 600 MHz (IEC 48B/1328/CD:2003)

DIN IEC 60603-7-41

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-41: Bauartspezifikation für ungeschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, für Datenübertragungen bis 500 MHz (IEC 48B/1693/CD:2006)

DIN IEC 60603-7-51

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-51: Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, für Datenübertragungen bis 500 MHz (IEC 48B/1694/CD:2006)

DIN IEC 60603-7-71

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-71: Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, für Datenübertragungen bis 1000 MHz (IEC 48B/1695/CD:2006)

DIN IEC 60679-1

Quarzoszillatoren mit bewerteter Qualität - Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 49/710/CD:2005)

DIN IEC 60689

Messungen und Prüfverfahren für Schwingquarze bis 200 kHz und Standardwerte (IEC 49/747/CD:2005)

DIN IEC 60747-1

Halbleiterbauelemente – Teil 1: Allgemeines (IEC 47/1734/CD:2003)

DIN IEC 60747-4

Halbleiterbauelemente – Einzel Halbleiterbauelemente – Teil 4: Mikrowellendioden und Transistoren (IEC 47E/265/CD:2004)

DIN IEC 60747-9

Halbleiterbauelemente Einzel Halbleiterbauelemente – Teil 9: Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) (IEC 47E/258/CD:2004)

DIN IEC 60747-14-4

Diskrete Halbleiterbauelemente – Teil 14-4: Halbleiter Beschleunigungsaufnehmer (IEC 47E/220/CD:2002)

DIN IEC 60747-16-1/A1

Halbleiterbauelemente – Teil 16-1: Integrierte Mikrowellen-Verstärker (IEC 47E/264/CD:2004)

DIN IEC 60748-2-20

Halbleiterbauelemente – Integrierte Schaltungen – Teil 2-20: Digitale integrierte Schaltungen – Familienspezifikation – Integrierte Schaltungen mit niedrigen Versorgungsspannungen (IEC 47A/755/CD:2006)

DIN IEC 60748-4-3

Halbleiterbauelemente – Integrierte Schaltungen – Teil 4-3: Integrierte Interfaceschaltungen; Dynamische Merkmale für Analog-Digital-Konverter (ADC) (IEC 47A/667/CD:2003)

DIN IEC 60749-20-1

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 20-1: Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung, Transport und Einsatz von feuchte / Reflow lötempfindlichen oberflächenmontierbaren Bauelementen (IEC 47/1775/CD:2004)

DIN IEC 60749-28

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 28: Prüfung der Empfindlichkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD); Charged Device Model (CDM) (IEC 47/1658/CD:2002)

DIN IEC 60749-35

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 35: Ultraschallmikroskopie für kunststoffverkappte Bauelemente der Elektronik (IEC 47/1769/CD:2004)

DIN IEC 60749-37

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 37: Prüfverfahren freier Fall von Bauelementen auf Leiterplatten für tragbare elektronische Geräte (IEC 47/1824/CD:2005)

DIN IEC 60749-38

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 38: Soft-Error-Rate bei elektronischen Bauelementen (IEC 47/1796/CD:2004)

DIN IEC 60749-39

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren – Teil 39: Messung des Feuchtediffusionskoeffizienten und der Wasserlöslichkeit in organischen Werkstoffen, welche bei integrierten Schaltungen verwendet werden (IEC 47/1797/CD:2004)

DIN IEC 60915

Kondensatoren und Widerstände für elektronische Geräte – Vorzugsmasse für Wellenenden, Buchsen und für die Einloch-Buchsenmontage von wellenbetätigten elektronischen Bauelementen (IEC 40/1592/CD:2005)

DIN IEC 60917-2-3

Modulordnung für die Entwicklung von Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Teil 2: Strukturnorm; Schnittstellen-Koordinationsmasse für die 25-mm-Bauweise; Hauptabschnitt 3: Erweiterte Massnorm; Masse für Baugruppenträger, Einschübe, Rückplatten, Frontplatten und steckbare Baugruppen (IEC 48D/285/CD:2003)

DIN IEC 61045-1

Netzwerke aus Schicht-Festwiderständen zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 40/1616/CD:2005)

DIN IEC 61051-1

Varistoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 40/1617/CD:2005)

DIN IEC 61076-1

Steckverbinder - Produktanforderungen - Teil 1: Fachgrundspezifikation (Ausgabe 2) (IEC 48B/880/CD:2000)

DIN IEC 61076-2-104

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 2-104: Rundsteckverbinder - Bauartspezifikation für Steckverbinder M8 mit Schraub- oder Rastverriegelung für Niederspannungsanwendungen (IEC 48B/1485/CD:2004)

DIN IEC 61076-2-105

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 2-105: Bauartspezifikation für Steckverbinder M5 mit Schraubverriegelung für Niederspannungsanwendungen (IEC 48B/1601/CD:2005)

DIN IEC 61076-3

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3: Rechteckige Steckverbinder - Rahmenspezifikation (IEC 48B/1358/CD:2003)

DIN IEC 61076-3-001

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-001: Rechteckige Steckverbinder - Vordruck für Bauartspezifikation (IEC 48B/1359/CD:2003)

DIN IEC 61076-3-104

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-104: Rechteckige Steckverbinder - Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8polig, für Datenübertragungen bis 1000 MHz (IEC 48B/1438/CD:2004)

DIN IEC 61076-3-105

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-105: Bauartspezifikation für 4-paarige symmetrische, einzeln geschirmte, feste und freie Steckverbinder mit 100 Ohm Wellenwiderstand für einen Frequenzbereich von 0 bis 1500 MHz (IEC 48B/1295/CD:2003)

DIN IEC 61076-3-106

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-106: 8-polige Steckverbinder für industrielle Umgebungen (IEC 48B/1165/CD:2002)

DIN IEC 61076-3-107

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Bauartspezifikation für geschirmte rechteckige Steckverbinder für USB mit Stromversorgung, Serie A (IEC 48B/1209/CD:2002)

DIN IEC 61076-3-108

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Bauartspezifikation für geschirmte rechteckige Steckverbinder für USB mit Stromversorgung, Serie B (IEC 48B/1210/CD:2002)

DIN IEC 61076-3-110

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-110: Rechteckige Steckverbinder; Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8-polig, für Datenübertragungen bis 600 MHz (IEC 48B/1360/CD:2003)

DIN IEC 61076-3-113

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-113: Geschirmte, serielle mehradrige Kabel zu Leiterplatten Steckverbinder für Übertragungsraten von 10 Gbit/sec (IEC 48B/1437/CD:2004)

DIN IEC 61076-3-114

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-114: Rechteckige Steckverbinder - Schutzgehäuse für die Anwendung mit 8-poligen geschirmten und ungeschirmten Steckverbindern für Frequenzen bis 600 MHz für industrielle Umgebungen zur Aufnahme der Schnittstelle der Reihe IEC 60603-7 - Ausführung 11 zu IEC 61076-3-106 - Bajonettausführung (IEC 48B/1667/CD:2006)

DIN IEC 61076-3-115

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-115: Rechteckige Steckverbinder - Schutzgehäuse für die Anwendung mit 8-poligen geschirmten und ungeschirmten Steckverbindern für Frequenzen bis 600 MHz für industrielle Umgebungen zur Aufnahme der Schnittstelle der Reihe IEC 60603-7 - Ausführung 12 zu IEC 61076-3-106 - Push pull Ausführung (IEC 48B/1668/CD:2006)

DIN IEC 61076-3-116

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 3-116: Rechteckige Steckverbinder - Schutzgehäuse für die Anwendung mit 8-poligen geschirmten und ungeschirmten Steckverbindern für Frequenzen bis 600 MHz für industrielle Umgebungen zur Aufnahme der Schnittstelle der Reihe IEC 60603-7 - Ausführung 13 zu IEC 61076-3-106 - Bajonettkupplung mit Federklemme (IEC 48B/1669/CD:2006)

DIN IEC 61076-7-100

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Teil 7-100: Kabelausgangszubehör - Bauartspezifikation für eine metrische Kabelabdichtung, bestehend aus einem integrierten Teil von stark beanspruchbaren Steckverbinderhaubengehäusen oder Rundsteckverbindergehäusen und einem Dichtungssystem (IEC 48B/1439/CD:2004)

DIN IEC 61163-1

Zuverlässigkeitsvorbehandlung durch Beanspruchung – Teil 1: Instand setzbare Einheiten, losweise gefertigt (IEC 56/845/CD:2003)

DIN IEC 61163-3

Zuverlässigkeitsvorbehandlung durch Beanspruchung – Teil 3: Instandsetzbare einzelne Einheiten (IEC 56/951/CD:2004)

DIN IEC 61188-5-8

Leiterplatten und Elektronikaufbauten auf Leiterplatten – Konstruktion und Anwendung – Teil 5-8: Sektionale Anforderungen – Betrachtungen zur Montage (Landefläche/Verbindung) – Flächenmatrix-Bauelemente (BGA, FBGA, CGA, LGA) (IEC 91/416/CD:2003)

DIN IEC 61189-2/A2

Änderung 2 zu IEC 61189-2: Prüfverfahren für Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen und Baugruppen – Teil 2: Prüfverfahren für Materialien für Verbindungsstrukturen (IEC 91/313/CD:2002)

DIN IEC 61189-3/A2

Änderung 2 zu IEC 61189-3: Prüfverfahren für Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen und Baugruppen – Teil 3: Prüfverfahren für Verbindungsstrukturen (IEC 91/314/CD:2002)

DIN IEC 61189-5

Prüfverfahren für Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen und Baugruppen – Teil 5: Prüfverfahren für bestückte Leiterplatten (IEC 91/310/CD:2002)

DIN IEC 61189-6

Prüfverfahren für Elektromaterialien, Verbindungsstrukturen und Baugruppen – Teil 6: Prüfverfahren für Materialien, die bei der Herstellung elektronischer Baugruppen eingesetzt werden (IEC 91/315/CD:2002)

DIN IEC 61190-1-2

Verbindungsmaterialien für Baugruppen der Elektronik – Teil 1-2: Anforderungen an Lotpaste für hochwertige Verbindungen in der Elektronikmontage (IEC 91/520/CD:2005)

DIN IEC 61190-1-3

Verbindungsmaterialien für Baugruppen der Elektronik – Teil 1-3: Anforderungen an Elektroniklote und an Festformlote mit oder ohne Flussmittel für das Löten von Elektronikprodukten (IEC 91/521/CD:2005)

DIN IEC 61192-5

Anforderungen an das Produktverhalten – Teil 5: Nacharbeit, Änderungen und Reparatur von gelöteten elektronischen Baugruppen (IEC 91/326/CD:2002)

DIN IEC 61193-2

Qualitätsbewertungssysteme – Teil 2: Auswahl und Anwendung von Stichprobenanweisungen für die Prüfung elektrischer Bauelemente und Gehäuse (IEC 91/509/CD:2005)

DIN IEC 61249-6-3

Materialien für Verbindungsstrukturen – Teil 6-3: Rahmenspezifikationen für Verstärkungsmaterialien; Glasgewebe (IEC 91/393/CD:2003)

DIN IEC 61587-1

Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Prüfungen für IEC 60917 und IEC 60297 – Teil 1: Klimatische, mechanische Prüfungen und Sicherheitsaspekte für Schränke, Gestelle und Baugruppenträger (IEC 48D/325/CD:2005)

DIN IEC 61587-1

Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Prüfungen für IEC 60917 und IEC 60297 – Teil 1: Klimatische, mechanische Prüfungen und Sicherheitsaspekte für Schränke, Gestelle und Baugruppenträger (IEC 48D/325/CD:2005)

DIN IEC 61587-3

Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen – Prüfungen für IEC 60917 und IEC 60297 – Teil 3: Schirmdämpfungsprüfungen für Schränke, Gestelle und Baugruppenträger (IEC 48D/310/CD:2004)

DIN IEC 61747-5-2

Flüssigkristall Anzeige Bauelemente – Teil 5-2: Sichtprüfung von Flüssigkristall Anzeigemodulen mit Aktiv-Matrix Adressierung (Aktiv-Matrix LCD's) (IEC 110/75/CD:2006)

DIN IEC 61747-6-3

Flüssigkristall Anzeige Bauelemente – Teil 6-3: Messverfahren für Bewegungsartefakte bei aktiv Matrix LCD-Modulen (IEC 110/86/CD:2006)

DIN IEC 61760-2

Oberflächenmontagetechnik - Teil 2: Transport- und Lagerungsbedingungen von oberflächenmontierbaren Bauelementen (SMD) - Anwendungsleitfaden (IEC 91/461/CD:2004)

DIN IEC 61967-3

Integrierte Schaltungen - Messung von elektromagnetischen Aussendungen im Frequenzbereich von 150 kHz bis 1 GHz - Teil 3: Messung der abgestrahlten Aussendungen; Verfahren der Oberflächenabtastung (IEC 47A/674/CD:2003)

DIN IEC 61967-6/A1

Integrierte Schaltungen - Messung von elektromagnetischen Aussendungen im Frequenzbereich von 150 kHz bis 1 GHz - Teil 6: Messung der leitungsgeführten Aussendungen - Magnetsondenverfahren (IEC 47A/720/CD:2005)

DIN IEC 61988-2-3

Plasmabildschirme - Teil 2-3: Messverfahren - Qualität (IEC 110/52/CD:2005)

DIN IEC 61988-3-2

Plasmabildschirme - Teil 3-2: Elektrische Schnittstellen (IEC 110/63/CD:2005)

DIN IEC 61988-4

Plasmabildschirme - Teil 4: Umwelt-, Lebensdauer- und mechanische Prüfverfahren (IEC 110/02/CD:2003)

DIN IEC 61988-5

Plasmabildschirme - Teil 5: Fachgrundspezifikation (IEC 110/80/CD:2006)

DIN IEC 61994-1

Piezoelektrische und dielektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion - Wörterverzeichnis - Teil 1: Piezoelektrische und dielektrische Resonatoren (IEC 49/755/CD:2006)

DIN IEC 61994-4-1

Piezoelektrische und dielektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion - Wörterverzeichnis - Teil 4-1: Piezoelektrische Materialien - Synthetische Quarzkristalle (IEC 49/756/CD:2006)

DIN IEC 61994-4-4

Piezoelektrische und dielektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion - Wörterverzeichnis - Teil 4-4: Materialien - Materialien für SAW-Bauelemente (IEC 49/642/CD:2004)

DIN IEC 62047-2

Bauteile der Mikrosystemtechnik - Teil 2: Prüfverfahren zur Zugbeanspruchung bei Dünnschicht-Werkstoffen (IEC 47/1759/CD:2004)

DIN IEC 62047-3

Bauteile der Mikrosystemtechnik - Teil 3: Dünnschicht-Standardmikroprobe (IEC 47/1760/CD:2004)

DIN IEC 62047-4

Halbleiterbauelemente - Bauteile der Mikrosystemtechnik - Teil 4: Fachgrundspezifikation für Bauteile der Mikrosystemtechnik (IEC 47/1857/CD:2006)

DIN IEC 62132-3

Integrierte Schaltungen - Messung der elektromagnetischen Störfestigkeit, 150 kHz bis 1 GHz - Teil 3: Stromeinspeisungsverfahren, 10 kHz bis 1 GHz (IEC 47A/670/CD:2003)

DIN IEC 62137-1-1

Oberflächenmontagetechnik - Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen Lötverbindungen - Teil 1-1: Zugfestigkeitsprüfung (IEC 91/519/CD:2005)

DIN IEC 62137-1-2

Oberflächenmontagetechnik - Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen Lötverbindungen - Teil 1-2: Scherfestigkeitsprüfung (IEC 91/523/CD:2005)

DIN IEC 62137-1-3

Oberflächenmontagetechnik - Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen Lötverbindungen - Teil 1-3: Zyklische Fallprüfung (IEC 91/614/CD:2006)

DIN IEC 62197-1

Steckverbinder - Qualitätsbewertungsanforderungen - Teil 1: Fachgrundspezifikationen (IEC 48B/879/CD:2000)

DIN IEC 62215-2

Integrierte Schaltungen - Messung der Störfestigkeit gegen Impulse - Teil 2: Impulseinspeisungsverfahren (IEC 47A/730/CD:2005)

DIN IEC 62258-3

Halbleiter Chip Erzeugnisse - Teil 3: Empfehlungen für die Praxis bei Handhabung, Verpackung und Lagerung (IEC 47/1750/CD:2004)

DIN IEC 62258-5

Halbleiter Chip Erzeugnisse - Teil 5: Anforderungen an Angaben hinsichtlich der elektrischen Simulation (IEC 47/1807/CD:2005)

DIN IEC 62258-6

Halbleiter Chip Erzeugnisse - Teil 6: Anforderungen zu Angaben hinsichtlich der thermischen Simulation (IEC 47/1808/CD:2005)

DIN IEC 62326-3

Leiterplatten - Teil 3: Sicherheitszertifizierung von starren Leiterplatten für elektronische Baugruppen (IEC 91/384/CD:2003)

DIN IEC 62341-1

Anzeigen mit organischen Leuchtdioden (OLED) - Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 110/38/CD:2004)

DIN IEC 62341-2

Anzeigen mit organischen Leuchtdioden (OLED) - Teil 2: Begriffe (IEC 110/20/CD:2004)

DIN IEC 62341-6

Anzeigen mit organischen Leuchtdioden (OLEDs) - Teil 6: Messverfahren (IEC 110/55/CD:2005)

DIN IEC 62373

Stabilität von Mosfet unter Temperatur Spannungs- Beanspruchung (IEC 47/1763/CD:2004)

DIN IEC 62374

Beanspruchung auf zeitabhängigen dielektrischen Durchbruch (TDDB) (IEC 47/1764/CD:2004)

DIN IEC 62391-1

Elektrische Doppelschichtkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 1: Fachgrundnorm (IEC 40/1378/CD:2003)

DIN IEC 62391-2

Elektrische Doppelschichtfestkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 2: Rahmenspezifikation: Elektrische Doppelschichtfestkondensatoren für Leistungsanwendungen (IEC 40/1379/CD:2003)

DIN IEC 62391-2-1

Elektrische Doppelschichtfestkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik - Teil 2-1: Vordruck für Bauartspezifikation: Elektrische Doppelschichtfestkondensatoren für Leistungsanwendungen; Bewertungsstufe EZ (IEC 40/1380/CD:2003)

DIN IEC 62404

Integrierte Schaltungen - Standard für I/O-Interfacemodelle für integrierte Schaltungen (IMIC, Version 1.3) (IEC 47A/704/CD:2004)

DIN IEC 62421

Elektronikmodule - Fachgrundnorm (IEC 91/546/CD:2005)

DIN IEC 62433

Modelle integrierter Schaltungen für die Simulation des Verhaltens bei elektromagnetischer Beeinflussung (IEC 47A/726/CD:2005)

DIN IEC 62468

Kennzeichnungen für das Vorhandensein und das Nichtvorhandensein der festgelegten chemischen Stoffe in Werkstoffen, Bauelementen und Leiterplatten in Geräten der Elektrotechnik und Elektronik (IEC 91/612/CD:2006)

DIN ISO 10110-17

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 17: Zerstörschwelle für Laserstrahlung (ISO 10110-17:2004)